

注意事項

1. 使用限制: 本機台為 12 吋設備，除了 12 吋晶片可直接進行製程外，其餘尺寸試片皆須貼片進行。
2. 貼片方式為使用黃色耐熱膠進行貼片。禁止其他膠類使用。
3. 小於 8 吋試片於蝕刻時，可能無法觀測到明顯的光譜變化，故無法利用 End-point 方式停止於指定位置。
4. 為避免 particle 以及真空度影響，禁止光阻進入，建議使用其他 hard-mask 材料，如 Ta、SiO₂...等，先於其他蝕刻機定義完再使用此設備蝕刻。
5. 此設備以蝕刻奈米尺寸之結構為主，蝕刻結果可能需另送 SEM 或 TEM 觀測，才能再行調整。SEM 或 TEM 的觀測需自行委託材料分析組進行觀測。
6. 非標準製程務必和機台負責工程師連絡討論可行性，欲送件前如有任何問題請與機台負責工程師連絡。